RD-ECR (Engineering Change Request)

申請人: 韌體課/吳文正　　表單號: 44　申請日期: 2026-07-13

Proposed Change	☑ Design modification 設計修改 ☐ Second source change 替代料變更 ☐ Material change 材料變更 ☐ Manufacturer change 製造商變更 ☐ Process sequency change 工序變更 ☐ Factory change 工廠變更 ☐ Equipment/Tooling change 設備/模具變更 ☐ Process/Method/Condition change 加工流程/方法 /條件變更 ☐ Others 其他			EC No	EC26070801
-	N/A			Initiator	吳文正(D0527)
Reason for Change	1.EDID 燒錄增加 DDCCI command,改善工廠生產效率. 2.修改 backlight PWM頻率 , 增加 CA410調校設備.			Issue Date	2026-07-13
Model / Part No	RUP2433AMI_D / 1A1A24260112201			Requester Dept	DV11S006-產品管理部
Implementation Type	○ 1. Immediately Change 立即切換 ◉ 2. Running Change 自然切換 ○ 3. Other 其他			-	N/A
PM	曹嘉雯(D0572)	Sales	胡靜文(D0547)	File attached 附件上傳	設計變更審查會議記錄 RUP... QRC-L-016-L719_Firmwar... Product Verification Repor...
Customer Approval	○ Needed ◉ Not needed	Customer Name	PHILIPS	Customer Sign-off Area 客戶簽核	
Invalid	◉ No ○ Yes	-			

Material Change Description 物料變更說明

No	Subassembly	T	PartNo	Description	Qty	Location	Stock	Remark
1	2AAD562R127	B	8SWD562V11C	FW (RUP2433AMI_250808R0V01)	1.000	2AAD536R038(U502)		Firmware change
1	2AAD562R127	A	8SWD562V11D	FW (RUP2433AMI_250808R0V01)(045C-C15A)	1.000	2AAD536R038(U502)		Firmware change

Engineering Change Assessment Item List 工程變更評估項目清單

1. Application for Revision of Specification or Drawing(s) for delivery 是否有修改交貨的規格或圖面	1.Confirm	○ Yes ◉ No need	1.Remark	NA
2. Standards or Regulatories impact 是否有評估適用之標準或主管機關之相關法規的申請	2.Confirm	○ Yes ◉ No need	2.Remark	No need
3. Change point of PCB mounting PCBA插件位置是否變更	3.Confirm	○ Yes ◉ No need	3.Remark	NA
4. PCBA Process Changes PCBA製程是否變更	4.Confirm	○ Yes (Continue checking below) ◉ No	4.Remark	No need
_ 4-1) Change of Reflow temperature 迴焊溫度是否變更	4-1 Confirm	○ Yes ◉ No need	4-1.Remark	No need
_ 4-2) Change of bonding temperature 膠合溫度是否變更	4-2 Confirm	○ Yes ◉ No need	4-2.Remark	No need
_ 4-3) Change of Manual Soldering temperature 人工手焊工具之溫度是否變更	4-3 Confirm	○ Yes ◉ No need	4-3.Remark	No need
_ 4-4) Change of storage condition after protection humidity package 防潮包裝完成後的儲存條件是否變更	4-4 Confirm	○ Yes ◉ No need	4-4.Remark	No need
5. Reliability test report(Test result and data) 是否有可靠性測試報告(測試結果及數據)	5.Confirm	◉ Yes ○ No need	5.Remark	參考附件

6. Process FMEA(Medical only) 是否有進行製程失效模式與效應分析	6.Confirm	○ Yes ● No need	6.Remark	No need
7. Design FMEA(Medical only) 是否有進行設計失效模式與交應分析	7.Confirm	○ Yes ● No need	7.Remark	NA
8. Risk Management(Medical only) 是否有進行風險管理評估	8.Confirm	○ Yes ● No need	8.Remark	NA
9. Change points due to the modification 是否此修改會延伸導致其他變更點	9.Confirm	○ Yes ● No need	9.Remark	NA
10. Initial Supply Control implements plan or result 是否有實施供料控制評估	10.Confirm	○ Yes ● No need	10.Remark	材料無需處理，變更調校
_ 10-1) Confirm the work order or order number or date for the implementation start of the engineering change 確認工程變更開始實施之工單或訂單號碼或日期	10-1 Confirm	● Yes ○ No need	10-1.Remark	工單1007822導入 CA410調校設備
_ 10-2) Coordinate the handling methods for related products and materials 協調相關產品及材料處理方法	10-2 Confirm	○ Yes ● No need	10-2.Remark	材料無需處理，變更調校
_ 10-3) Arrange th production schedule 處理生產日程之安排	10-3 Confirm	● Yes ○ No need	10-3.Remark	工單1007822導入 2026.07.24備料
_ 10-4) Control the changed materials 變更材料之管制	10-4 Confrim	○ Yes ● No need	10-4.Remark	材料無需處理，變更調校
_ 10-5) Establish relevant execution control records for EC materials, register traceability data for each material 建立有關工程變更物料之相關執行管控記錄、登錄各項物料追溯性資料	10-5 Confirm	● Yes ○ No need	10-5.Remark	導入工單1007822 1A1A24260112201 RUP2433AMI_D
11. Training Requirement 若此一變更影響製程或檢驗，是否需要再做人員訓練	11.Confrim	○ Yes ● No need	11.Remark	No need
12-1. Modification contents(For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件(如下)	12-1 Confirm	☑ QC control plan ☐ Service Manual ☐ Others ☐ Not needed	12-1.Remark	control plan需修改
12-2. Modification contents(For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件(如下)	12-2 Confirm	☑ SIP ☑ SOP ☐ Others ☐ No need	12-2.Remark	SOP,SIP須修改.
12-3. Modification contents(For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件(如下)	12-3 Confirm	☑ MDF ☑ DMR ☐ Approval Sheet ☐ Engineering Spec ☐ Others ☐ Not needed	12-3.Remark	NA
DIVA 鈺緯科技開發股份有限公司		版本：C		表單編號：QR-736-05

簽核列表 ● 表格 ○ 圖形

序號	簽核人	簽核結果	簽核意見
1	**王寶源** 二階主管(課/部級)	**同意** 2026-07-16 10:07	
2	**呂旻峰** ECR-DQE人員	**同意** 2026-07-16 15:32	驗證結果為Pass, 驗證報告參考附件內容.
2	**林雪清** ECR-DQE人員	**同意** 2026-07-17 13:34	
2	**林金封** ECR-DQE人員	**同意** 2026-07-17 13:34	
2	**張鈞凱** ECR-DQE人員	**同意** 2026-07-20 10:50	不影響EMI
3	**廖榮棋** DQE主管	**同意** 2026-07-20 11:37	
4	**曹嘉雯** PM	**同意** 2026-07-20 13:45	

序號	簽核人	簽核結果	簽核意見
4	**胡靜文** Sales	**同意** 2026-07-27 09:12	
5	**楊建勛** R&D Director [通知]	**同意** 2026-07-27 09:12	[通知]
6	**蕭玉桃** ECR-PIC人員	**同意** 2026-07-27 10:01	
7	**王世炫** ECR-PE人員	**同意** 2026-07-27 13:40	
7	**蔡博翔** [王世炫 加簽]FW變更須管理.	**同意** 2026-07-27 14:45	
7	**童嘉彬** [王世炫 加簽]FW變更,燒錄FW須管理.	**同意** 2026-07-27 16:31	
7	**鄭正宜** [王世炫 加簽]FW變更,SIP須變更.	**同意** 2026-08-03 11:38	
8	**林益銓** PE	**同意** 2026-08-03 18:27	
9	**黃振哲** ECR-PMC人員	**同意** 2026-08-05 09:21	庫存PCBA是共用版,不用重工.生產此機種再燒錄即可
10	**邱羽萱** PMC	**同意** 2026-08-05 09:32	
11	**林益銓** PD	**同意** 2026-08-05 09:42	
11	**李慧珊** ECR-SCM人員	**略過** 2026-08-05 09:47	不涉及採購
11	**黃瓊玉** ECR-PD人員	**同意** 2026-08-05 12:27	
12	**李金龍** ECR-QA人員	**同意** 2026-08-05 14:08	
13	**陳泰盛** QA	**同意** 2026-08-05 14:16	
14	**楊建勛** R&D Director	**同意** 2026-08-05 14:21	
15	**蕭玉桃** ECR-PIC人員	**同意** 2026-08-05 17:49	
16	**吳文正** SAP核發	**同意** 2026-08-06 08:35	